

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<div><div><div>●特定对象调研</div><div>□分析师会议</div></div><div><div>□媒体采访</div><div>□新闻发布会</div></div><div><div>□现场参观</div><div>□电话会议</div></div><div><div>□其他</div></div></div>
参与单位名称	国联民生证券、东北证券、华鑫证券、山西证券、野村东方国际证券、汇丰晋信基金、泰康资产、勤辰资产、翊安投资、远海私募等 12 人
时间	2024 年 4 月 29 日 15：00
地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<div>一、公司概况</div> <div>公司对 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩变化情况进行了说明，并对各业务板块的经营情况进行了介绍（部分摘要）：</div> <div>（一）硅片业务板块</div> <div>1.产能（截至 2024 年末）：6 英寸抛光片（含衬底片）产能 60 万片/月、8 英寸抛光片（含衬底片）产能 57 万片/月、6-8 英寸（兼容）外延片产能 82 万片/月；衢州基地 12 英寸抛光片（含衬底片）产能 15 万片/月、12 英寸外延片产能 10 万片/月；嘉兴基地 12 英寸抛光片产能 15 万片/月。</div> <div>2.产能利用率：</div> <div>（1）6-8 英寸外延片产能自 2024 年第二季度至今产能利用饱满，其中 8 英寸订单目前处于供不应求。主要原因：1.市场对厚外延片的需求较高；2.金瑞泓在重掺工艺的技术领先，具有较高产品竞争力；3.受美国关税政策影响，进口替代加快。</div> <div>（2）12 英寸硅片稼动率 2024 年取得较大提升，目前正处于产能爬坡过程中。</div>

	<p>（二）功率器件芯片业务板块</p> <p>1.产能及产能利用率情况</p> <p>目前设备产能约为 23.5 万片/月，2024 年功率器件芯片销量 182.40 万片，较 2023 年同期增长 6.30%，目前稳定月产出约 17-18 万片。2024 年产品价格受光伏市场等因素的影响有所下降，毛利率有所降低。</p> <p>2.应用：公司积极调整产品结构，沟槽 SBD 产品占比提升；汽车电子芯片和 FRD 芯片供应国内比亚迪及某重要客户；今后将重点发展汽车电子芯片、FRD 芯片等，进一步优化产品结构。</p> <p>（三）化合物半导体射频芯片</p> <p>1.产能：杭州基地 9 万片/年；海宁基地 6 万片/年（已通线、正在调试和验证）。</p> <p>2.产品种类：1.手机功率放大器芯片，通过昂瑞微、唯捷创芯、锐石创芯等客户供应手机终端客户；2.航空航天等特殊用途芯片，宇航级射频芯片已实现低轨卫星终端规模化交付；3.VCSEL 芯片，公司二维可寻址大功率 VCSEL 工艺技术，成为全球首家量产车规级激光雷达 VCSEL 芯片的制造商，最新月出货约 400 片，后续会进一步提升。产品已应用于智能驾驶与机器人领域，在汽车补盲雷达中有较高的用途，在机器人、人脸识别、光通信等领域也会有较大的用途；4.碳化硅基氮化镓芯片，公司开发的国内第一款 6 英寸 0.45 微米的碳化硅基氮化镓（GaN HEMT）工艺技术取得重要进展，技术指标对标或超过竞品，6 英寸 0.25 微米的 GaN HEMT 工艺技术也在加紧开发中。</p> <p>3.具备技术：技术与国际头部同行处于同一梯队，客户已大范围覆盖，打破海外厂商垄断格局，确立国产替代领军地位。</p> <p>未来发展聚焦于：1. 12 英寸硅片的产能爬坡。2. 海宁基地化合物半导体射频芯片的验证和快速上量。3. 功率半导体产品结构优化，进一步提升汽车电子、FRD 芯片等高附加值产品；同时探索产品迭代，在现有功率产线设备的基础上增加少量瓶颈设备，实现功率产品的代际升级。</p> <p>二、投资者交流主要问题回复</p> <p>1.公司 6-8 英寸外延片兼容，其中 6 英寸和 8 英寸各占多少比例？</p> <p>答：2024 年底，6-8 英寸（兼容）外延片产能 82 万片/月，从设备端来讲，6-8 英寸产品可实现共享，具体比例根据客户订单需求及产品结构动态调整。</p> <p>2.公司 12 英寸大硅片基地中是否嘉兴全部是轻掺片、衢州全是重掺片？</p> <p>答：公司嘉兴基地 15 万片/月的产能全部是轻掺抛光片、衢州基地 15 万片/月的产能</p>
--	---

	<p>中 10 万片/月为重掺片，另有 5 万片轻掺片产能。</p> <p>3.公司 2022 年收购嘉兴基地（原国晶半导体）是基于什么考虑？</p> <p>答：基于如下考虑：1.快速扩大轻掺抛光片产能。原国晶半导体规划建设 40 万片/月的轻掺抛光片产能，其中首期建设 15 万片/月的产能，收购时嘉兴公司厂房和自动化设施已经建成且已有部分设备到位，收购后可以快速提升公司的轻掺产能；2.实现技术优势互补。嘉兴基地的技术团队源自德国世创（新加坡）12 英寸抛光片工厂，具备较强的轻掺技术实力；3.采用高标准建设。嘉兴基地当前是国内全自动化程度最高、智能化程度最高的 12 英寸硅片工厂。4.收购成本可控。基于建设成本加财务费用的价格进行收购，收购成本合理可控。</p> <p>4.公司 2025 年还会大量新增折旧费用么？</p> <p>答：公司 2025 年新增资本性开支不多。预计 2025 年新增的折旧主要是衢州 20 万片/月 8 英寸外延片项目以及海宁立昂东芯 6 万片/年的化合物半导体射频芯片项目届时转产增加的折旧。</p> <p>5.据传受美国关税政策的影响，部分客户的外延片需求将从美国转向国内，请问客户国产替代的决心和紧迫性如何？</p> <p>答：半导体产品的国产化替代是一个趋势，不可逆转。重掺硅片属于公司的拳头产品，在国内外拥有较强的市场竞争力，公司将充分发挥产品的技术优势，抓住市场机遇，不断提升市场份额。</p> <p>6.如何看待当前 12 英寸硅片产品的价格水平？</p> <p>答：当前国内 12 英寸硅片产品的价格已处于低位，且低于国外同类产品的价格水平，预计 12 英寸硅片产品的价格有望合理回升，回归合理的价格水平。</p>
资料清单 (如有)	无